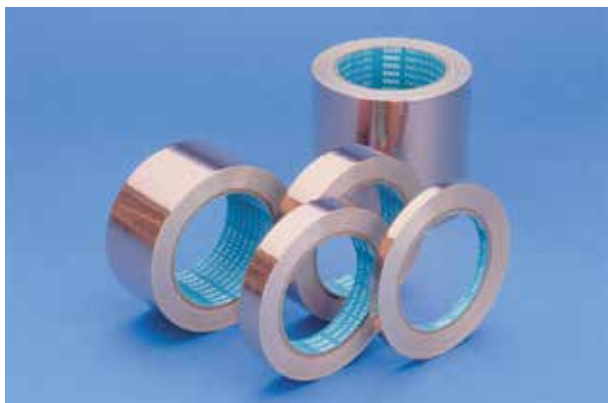


銅箔テープ

Copper foil tape

CU series



E203845

品番表

Product list

圧延銅箔（スタンダード品） Rolled copper foil (standard)

品番 Product code	巾(mm) Width (mm)	長さ(巻) Length (roll)	包装単位 Packaging quantity
CU- 8T	8.0	20m	25巻 /rolls
CU- 13T	13.0	20m	15巻 /rolls
CU- 19T	19.0	20m	10巻 /rolls
CU- 25T	25.0	20m	8巻 /rolls
CU- 50T	50.0	20m	4巻 /rolls
CU-100T	100.0	20m	2巻 /rolls
CU-250T	250.0	20m	5巻 /rolls
CU-500T	500.0	20m	2巻 /rolls

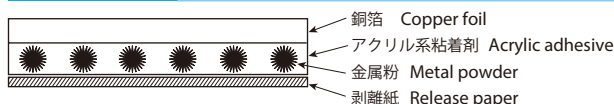
電解銅箔（薄型品） Electrolytic copper foil (thin)

品番 Product code	巾(mm) Width (mm)	長さ(巻) Length (roll)	包装単位 Packaging quantity
CU- 8ST	8.0	50m	25巻 /rolls
CU- 13ST	13.0	50m	15巻 /rolls
CU- 19ST	19.0	50m	10巻 /rolls
CU- 25ST	25.0	50m	8巻 /rolls
CU- 50ST	50.0	50m	4巻 /rolls
CU-100ST	100.0	50m	2巻 /rolls

※標準品以外の巾寸法品も製作できます。※切断加工品、異形加工品の製作もできます。
* Different widths other than the standard sizes are available.
* The tape is available in cut strips or odd shapes.

構造

Structure



特長

Features

- フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
- 金属箔にはんだ付けができます。
- 製品厚み 95 μ m と 53 μ m の 2 タイプを用意しております。
- UL510 (FR) 認定品です。

This flexible tape is easily wound or applied using adhesive. Incorporates a conductive adhesive that doesn't impair shielding. The metal foil can be soldered. The tape comes in two different thicknesses, 95 μ m and 53 μ m. UL 510 (FR) rated.

用途

Applications

- 筐体のグラウンディング、シールドング。
- ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディングシールドング。
- EMI シールドルーム。
- シールド特性測定時の緊急対策として最適です。

Chassis grounding and shielding. Grounding and shielding of cable harnesses and connectors. EMI shield room. Emergency measures during shield characteristics measurement.

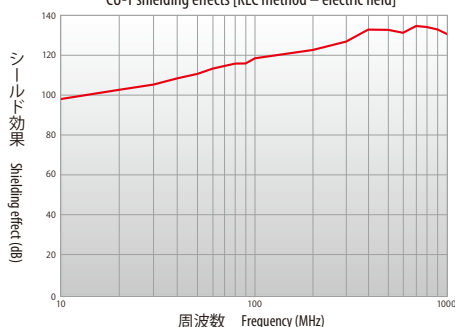
特性

Physical properties

タイプ Type	スタンダード Standard	薄型 Thin
品名 Description	CU-T	CU-ST
金属箔厚み (μ m) Metal foil thickness (μ m)	35	18
粘着層厚み (μ m) Adhesive layer thickness (μ m)	60	35
製品厚み (μ m) Product thickness (μ m)	95	53
接着力 (N/25mm) 180°ピール対SUS Adhesive strength (N/25 mm) 180° peel from SUS	10以上 10 or more	10以上 10 or more
接触抵抗値 (Ω /25mm \square /19.6N) Contact resistance (Ω /25 mm \square /19.6N)	0.003	0.002
難燃性 Flammability	UL510FR	

シールド効果

Shielding effect

CU-T シールド効果 [KEC法-電界]
CU-T shielding effects (KEC method - electric field)CU-ST シールド効果 [KEC法-電界]
CU-ST shielding effects (KEC method - electric field)